



株式会社 アルバック

2026年6月期 第1四半期 決算説明資料

2025年7月～2025年9月

2025年11月11日

将来見通し等に関する記述についての注意事項

- **将来見通しについて**
本資料に記載の業績見通しならびに将来予測は、現在入手可能な情報に基づき作成されたものです。世界経済情勢、半導体・電子部品・FPD・原材料などの市況、設備投資の動向、急速な技術革新への対応、為替レートの変動など様々な要因により、実際の業績・成果等はこれらの見通し・将来予測と大きく異なる可能性があることをご承知おください。
- **数字の処理について**
本資料に記載の数字・比率につきましては、単位未満四捨五入で処理しております。
- **品目名称変更について**
2025年6月期より、FPD製造装置の名称をディスプレイ・エネルギー関連製造装置に変更しております。

ULVAC

■ 2026年6月期 第1四半期 連結業績概要

- 受注高・売上高・各利益項目は概ね計画通りに着地
- 前年同期比・前4Q比で売上高減少およびミックス変化により一時的に利益率低下

■ 新中長期経営計画（バリューアッププラン）進捗

- 事業改革・生産改革などの取り組みは計画通りに進行中
早期実現に向けて各施策を推進中
- ポンプ用モーター事業：譲渡完了
マテリアル関連生産（日本富里工場）：生産終了

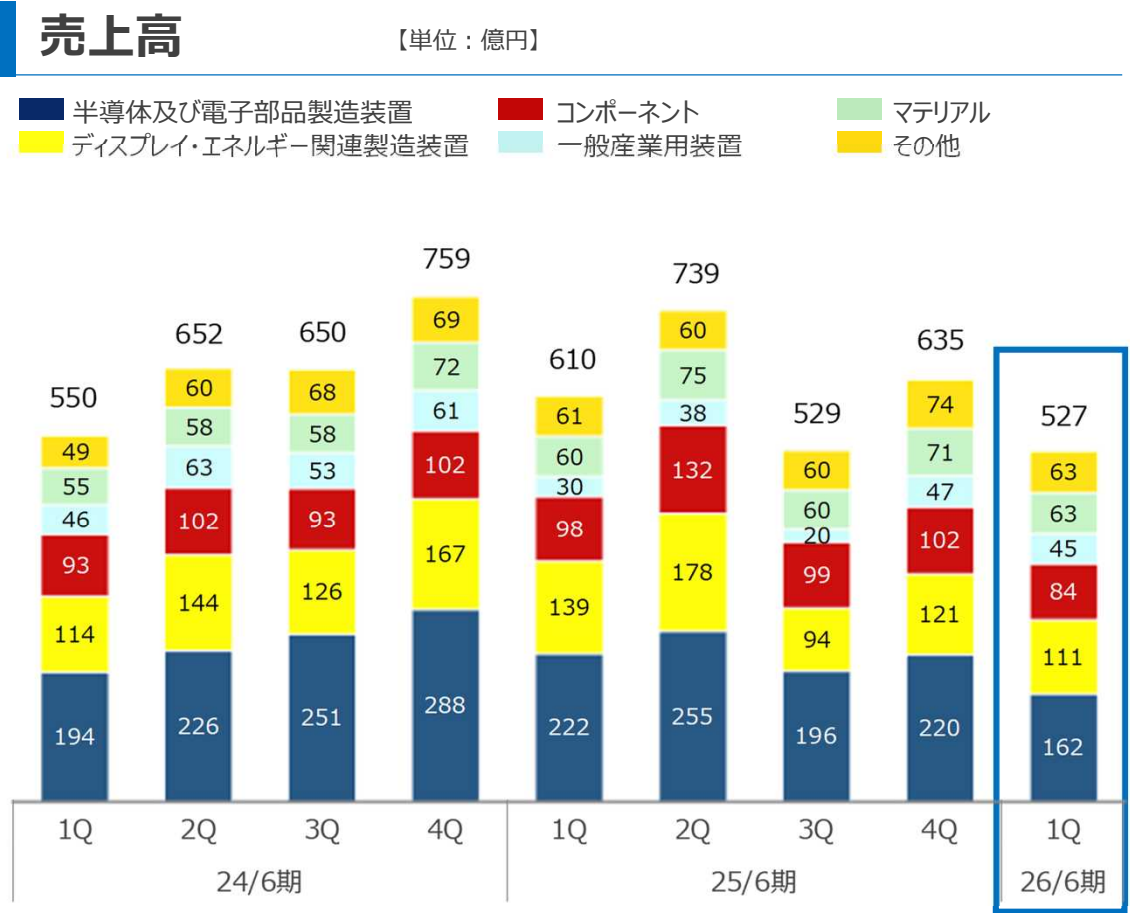
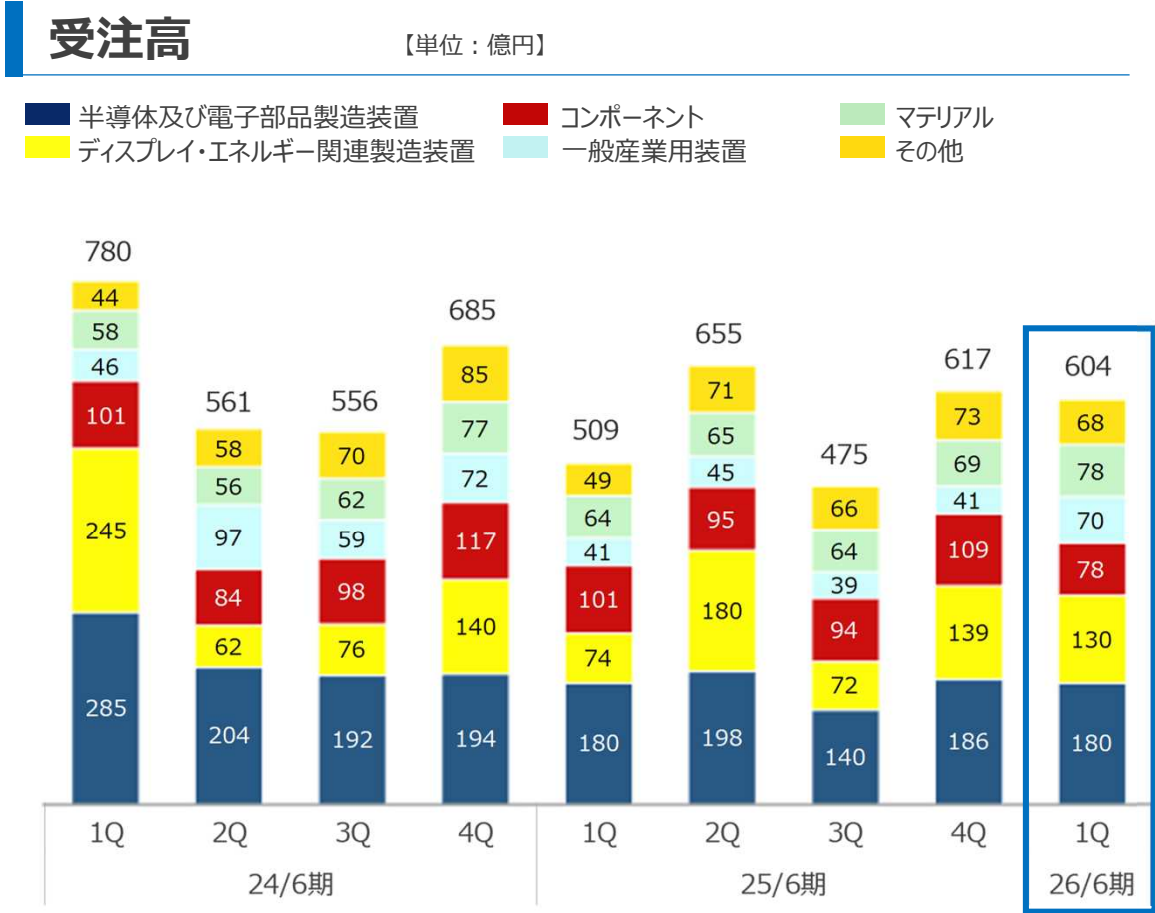
■ 2026年6月期 業績予想

- 下期にかけて着実な改善を見込み、業績予想・配当予想に修正なし

- 1Q受注高・売上高・各利益項目は概ね計画通りに着地
- 前年同期比・前4Q比で売上高減少およびミックス変化により一時的に利益率低下

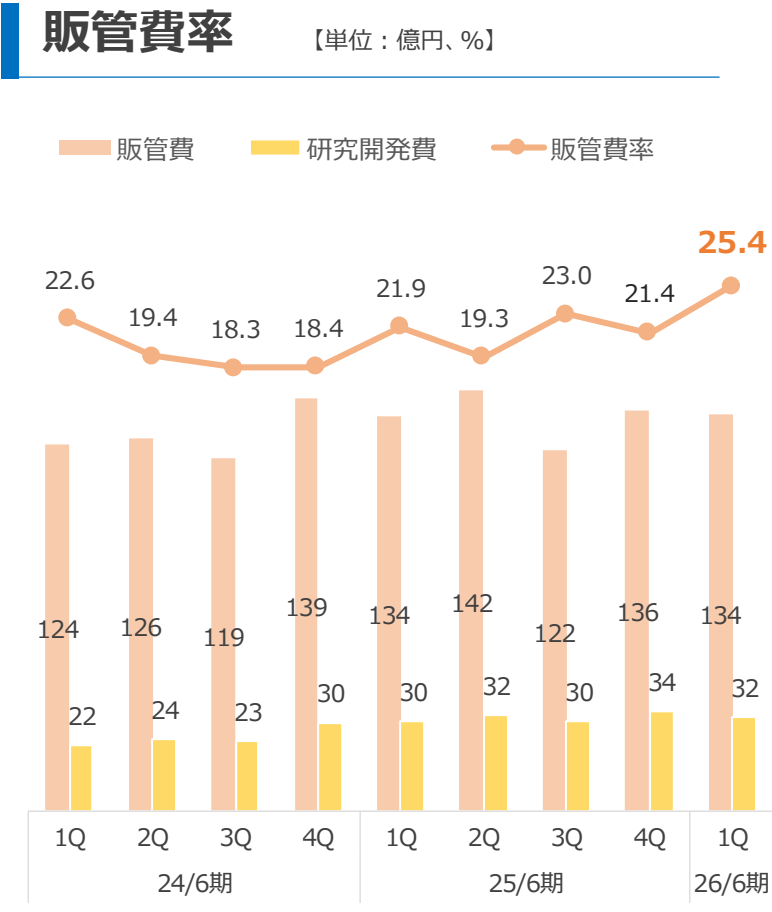
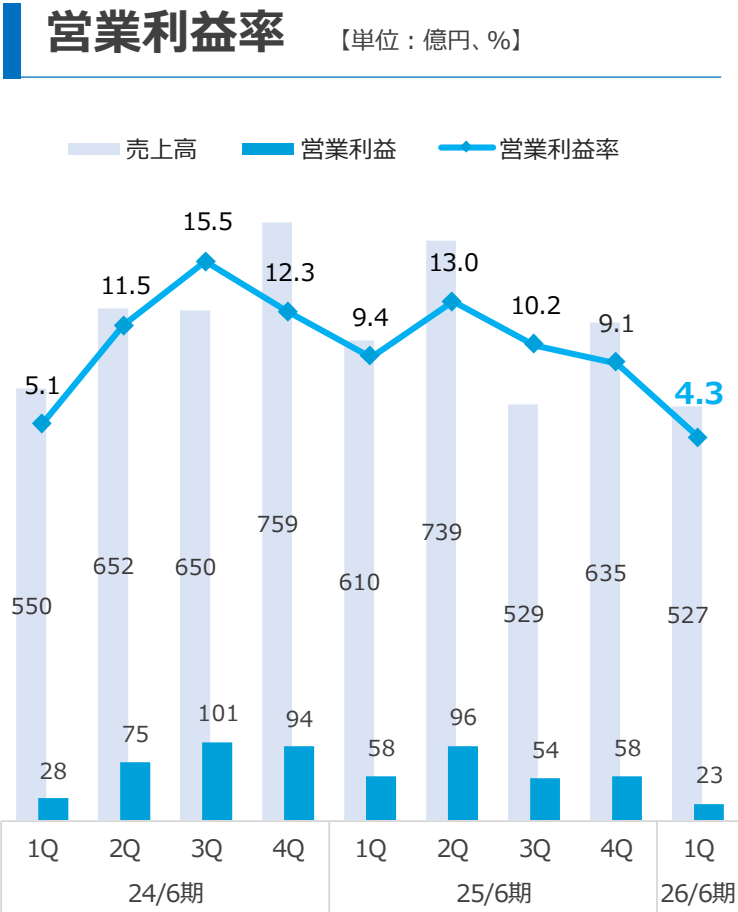
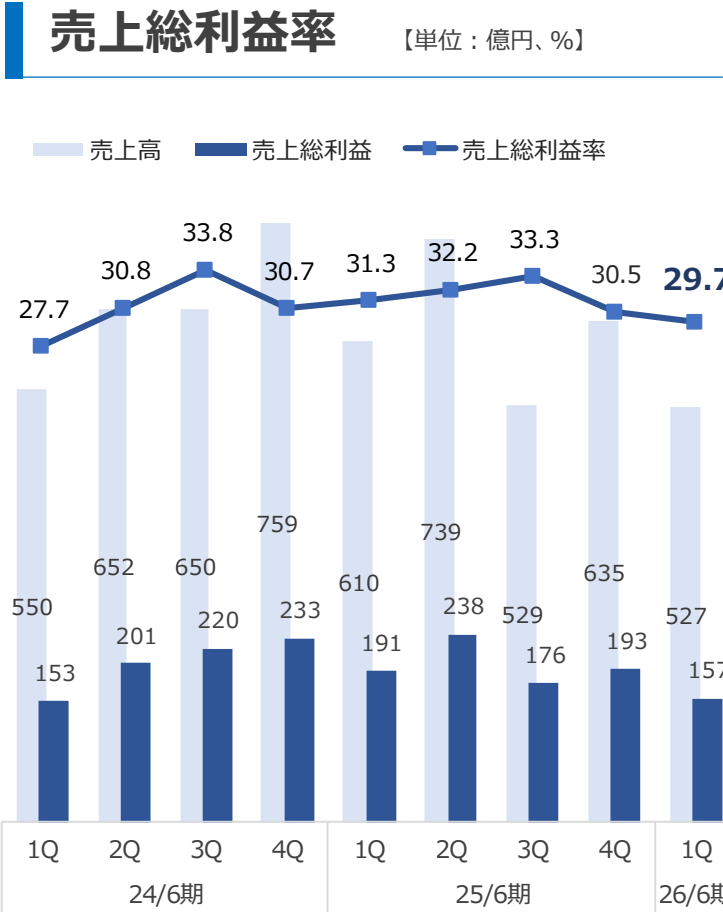
【単位：億円】	2025/6期					2026/6期		
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	前年同期比	
							増減額	増減率
受注高	509	655	475	617	2,256	604	+95	+19%
売上高	610	739	529	635	2,512	527	-83	-14%
売上総利益	191	238	176	193	799	157	-35	-18%
率	31.3%	32.2%	33.3%	30.5%	31.8%	29.7%	-1.6pt	
販管費	134	142	122	136	533	134	+0	+0%
営業利益	58	96	54	58	265	23	-35	-60%
率	9.4%	13.0%	10.2%	9.1%	10.6%	4.3%	-5.1pt	
経常利益	69	92	61	65	286	25	-44	-64%
率	11.3%	12.4%	11.5%	10.2%	11.4%	4.7%	-6.6pt	
親会社株主に帰属する 四半期純利益	37	67	27	36	167	17	-21	-55%
率	6.1%	9.0%	5.1%	5.6%	6.6%	3.2%	-3.0pt	

- » 受注高：OLED改造案件・追加投資継続等により、前年同期比増加
- » 売上高：概ね計画通りも、半導体電子の売上高構成比が一時的に低下

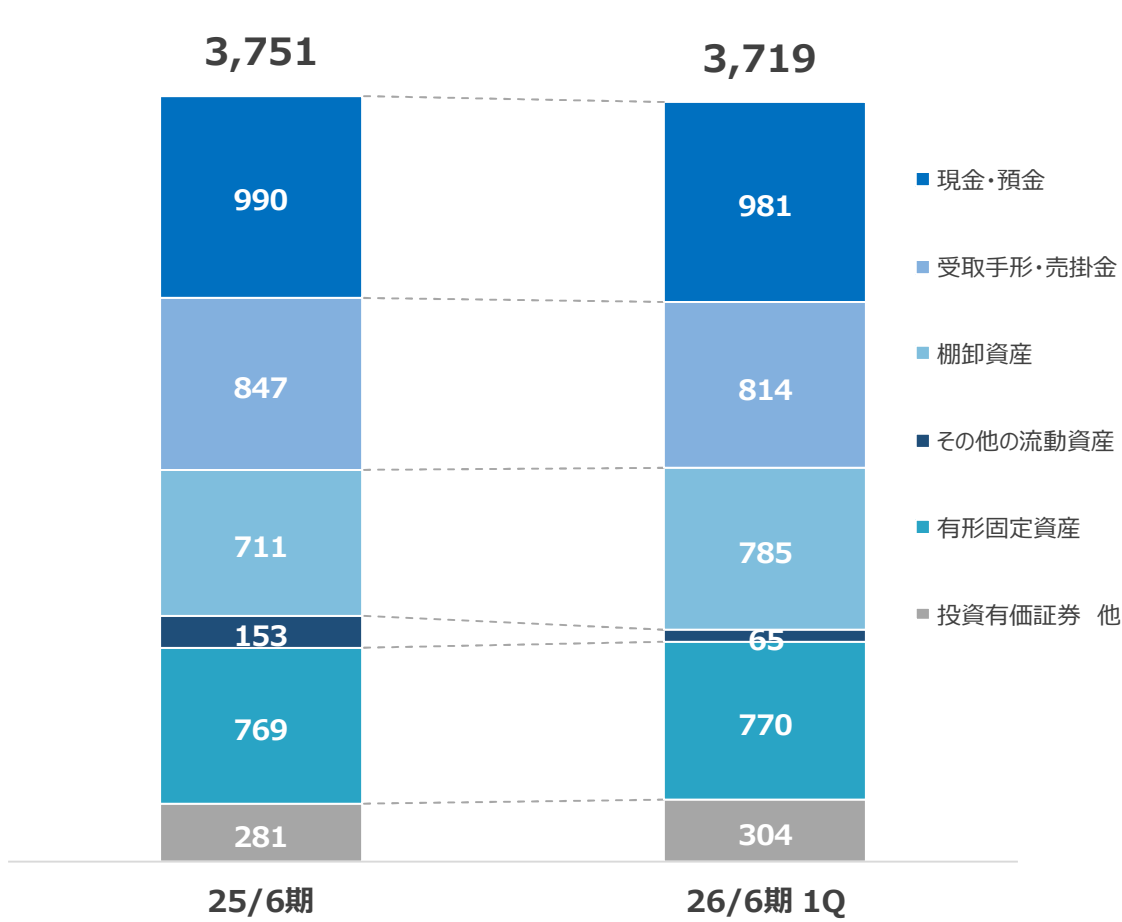


※ 26/6期より、リークテスト装置の受注高および売上高の分類を、コンポーネントから一般産業へ変更

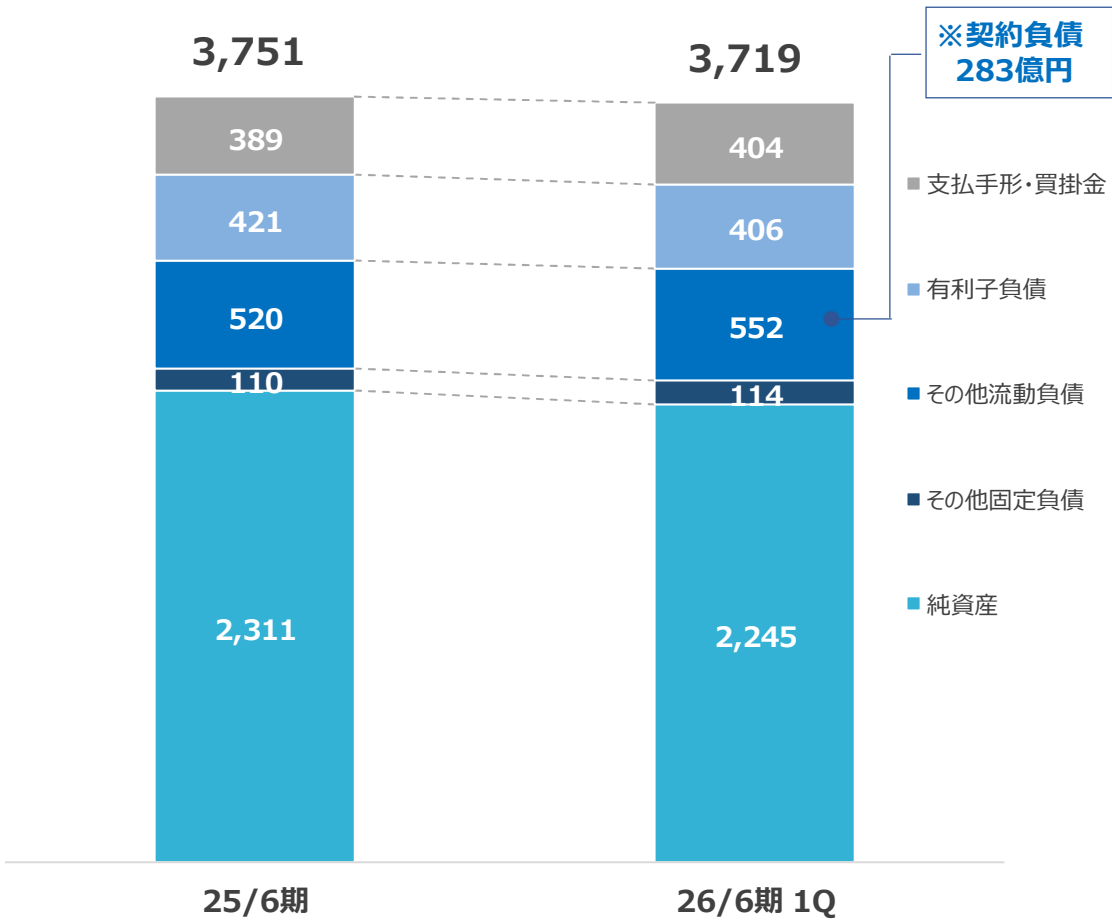
- » 売上総利益率：売上高減少およびミックス変化により一時的に低下
- » 営業利益率：売上総利益減少に加え、研究開発投資継続等により低下



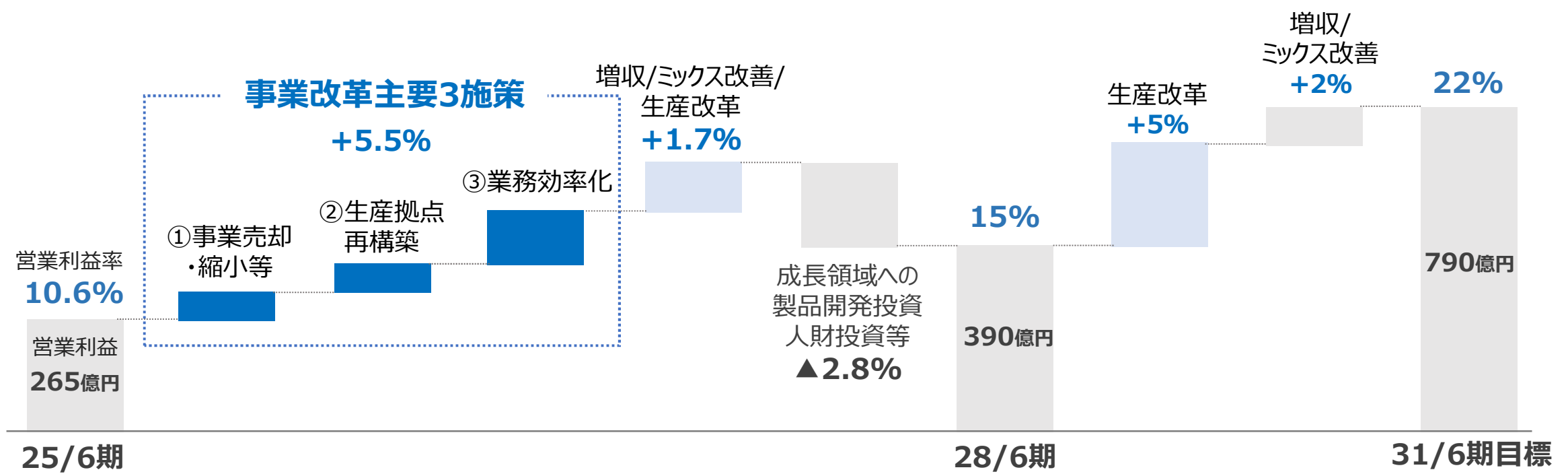
資産【単位：億円】



負債・純資産【単位：億円】

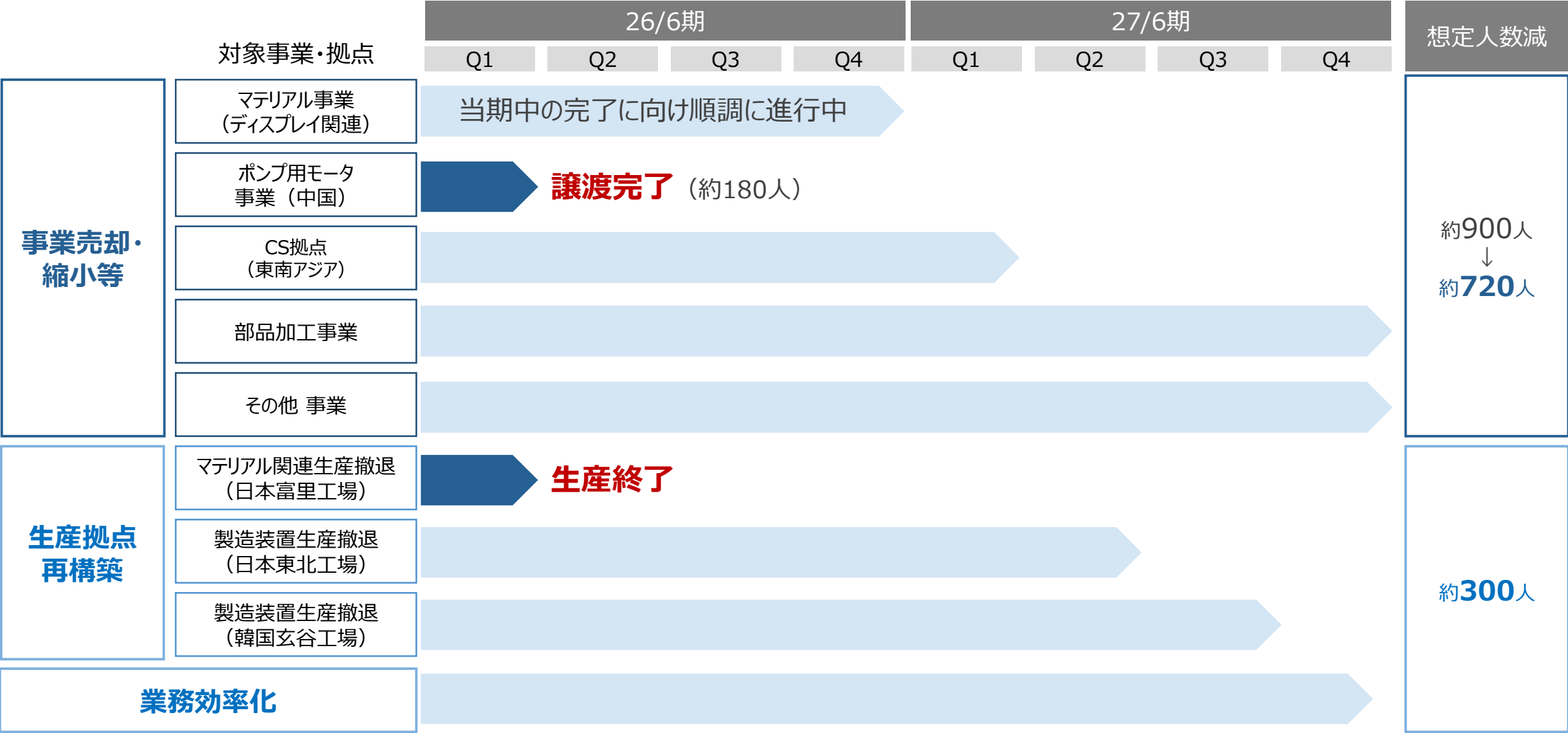


» 事業改革・生産改革などの取り組みは計画通りに進行中、早期実現に向けて各施策を推進中



	主要3施策	内容
事業改革	① 事業売却・縮小等	持分譲渡による非連結化を含み6事業の売却・縮小等に向けて交渉中 →1事業譲渡完了
	② 生産拠点再構築	工場縮小（1拠点） →生産終了 工場内一部事業の生産縮小後、他事業転用（2拠点）に向けて対応中
	③ 業務効率化	業務・機能の統合等による業務効率化に向けて対応中
生産改革		MD化による調達・部品共通化による変動費削減、設計・製造効率向上と拠点集約による固定費削減：進行中

» 事業売却・縮小：1件譲渡完了、生産拠点再構築：1件生産終了



品目	投資動向	CY25~26
半導体 ロジック・メモリ	- DRAM：HBM関連投資活況、新規顧客投資の1Qからの貢献 - NAND：次世代向け投資継続 - ロジック：先端ノード投資堅調、成熟ノードMHM工程展開の加速、北米における外資メーカーによる投資開始見込み	
各種電子デバイス	- 生成AI向けWLPビジネス継続、Hybrid bonding向け投資期待 - PLP開発投資見込み - AR/VR向け中国オプトデバイス投資見込み	
パワーデバイス	中国大手デバイスメーカー中心に8inchSiC投資の引き合い増加も一部顧客からの遅延要請等もあり受注タイミング遅延傾向	
ディスプレイ	IT OLED向け投資継続、設備追加・改造案件による持続的貢献	
バッテリー関連	- 複合集電体への期待が高まるも、依然として市場形成は不透明 - 銅両面蒸着膜・リチウム膜等を含め、中長期的な成長期待	
コンポーネント・一般産業・ マテリアル・その他	- 半導体電子等における各種設備投資継続により安定基盤ビジネスとして堅調に推移 - 先端デバイス等の研究開発活発化に伴い表面分析装置堅調	

- » 受注高：半導体投資回復、先端パッケージングビジネス活発化、OLED追加投資継続等で年間計画に変更なし
- » 売上高・各利益（率）：下期にかけて着実な改善を見込み、業績予想・配当予想に修正なし

【単位：億円】	25/6期	26/6期			前期比	
		上期予想	下期予想	通期予想	増減額	増減率
受注高	2,256	1,200	1,300	2,500	+244	+11%
売上高	2,512	1,155	1,345	2,500	-12	-0%
売上総利益	799	355	470	825	+26	+3%
率	31.8%	30.7%	34.9%	33.0%	+1.2pt	-
営業利益	265	90	195	285	+20	+7%
率	10.6%	7.8%	14.5%	11.4%	+0.8pt	-
経常利益	286	90	195	285	-1	-0%
率	11.4%	7.8%	14.5%	11.4%	-0.0pt	-
親会社株主に帰属する 当期純利益	167	65	135	200	+33	+20%
率	6.6%	5.6%	10.0%	8.0%	+1.4pt	-
1株あたり配当金（円）	164			164	-	

次世代半導体パッケージのコンソーシアム「JOINT3」に参画

JOINT3は、株式会社レゾナック社が設立した共創型評価プラットフォームで、材料・装置・設計企業が連携し、パネルレベル有機インターポーター向けの材料・装置・設計ツール開発を加速します。

当社は、プラズマアッシングやパネルレベルスパッタリング装置の実績を活かし、シードスパッタリング装置を導入して技術深化と装置改良を進め、パッケージ技術の課題解決と製品価値向上を目指します。

生成AIや自動運転の拡大に伴い、インターポーターの大型化によりシリコンから有機材料への移行や円形ウェハから四角パネル形状への転換が進んでいます。



Imec Programへの参加と今後の協業

当社は、ベルギーに拠点を置く先端半導体開発機関Imecのプログラムへの参加を決定しました。Imecは世界有数の研究開発機関として、最先端の半導体プロセス技術や材料開発において豊富な知見と高度な開発インフラを有しています。

当社は同機関との連携を通じて、これらの知見や開発環境を活用し、次世代およびその先の半導体デバイス開発を一層加速させることを目指します。

今回の参画により、グローバルな技術連携を強化し、持続的な技術革新に取り組んでまいります。



■ 品目別内訳割合

	受注高	売上高
半導体電子	180億円	162億円
・ メモリ	2割弱	3割弱
・ ロジック	3割強	2割弱
・ 電子部品	1割半ば	2割強
・ パワー半導体	数%	1割強
・ 実装	3割強	2割弱
ディスプレイ・エネルギー	130億円	111億円
・ LCD	4割強	3割強
・ OLED	5割弱	6割半ば
・ バッテリー	-	数%
・ その他	1割強	数%

■ 営業利益率順位

順位	品目
1	コンポーネント
2	一般産業
3	ディスプレイ・エネルギー
4	その他
5	材料
6	半導体電子

※全社平均営業利益率は 4)その他 と 5)材料 との間

ULVAC